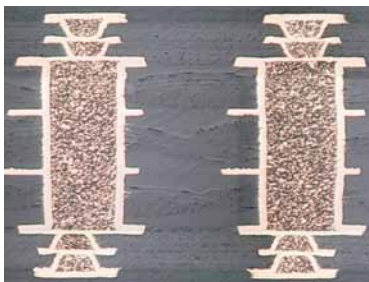
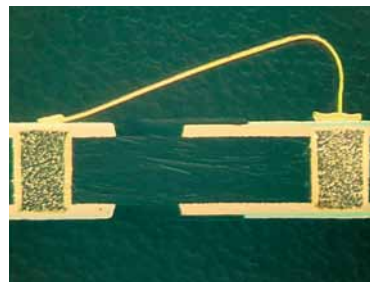


メッキビア用 非導電性・導電性穴埋ペースト

DDペースト AE1125DS / AE1125HD / AE3030



2-4-2スタックド・ビア型ビルドアップ基板
穴埋ペースト: AE1125HD

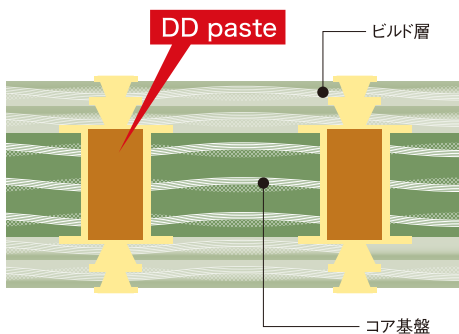


ビア・イン・パッド基板(サーマル・ビア)
穴埋ペースト: AE3030

特徴

- ▶熱伝導性に優れる
- ▶ポイドレス
- ▶平滑性に優れる
- ▶フタメッキの信頼性に優れる

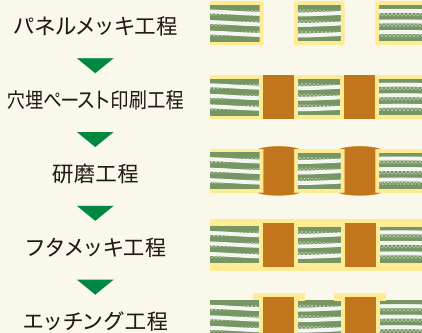
構造



物性・性状

	ロングライフグレード AE1125DS	汎用グレード AE1125HD	高熱伝導率グレード AE3030
金属粉	銅粉	銅粉	銀コート銅粉
樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂
溶剤	無溶剤	無溶剤	無溶剤
粘度(BH型) (pa·s)	140	160	150
硬化条件	仮乾燥	80°C/30min	80°C/30min
	本硬化	160°C/60min	160°C/60min
体積抵抗率 (Ω·cm)	10 ⁹⁻¹²	10 ⁹⁻¹²	2.0×10 ⁻⁴
Tg点(DMA) (°C)	210	163	171
線膨張係数	α1 (ppm)	44	36
	α2 (ppm)	80	83
熱伝導率 (W/mk)	1.1	1.4	7.8
メッキピール強度	粗化なし(N/cm)	—	4.5
	粗化あり(N/cm)	7.1	7.8

加工プロセス



長期信頼性

	ロングライフグレード AE1125DS		汎用グレード AE1125HD		高熱伝導率グレード AE3030	
項目	フタメッキ 剥離	膨れ量	フタメッキ 剥離	膨れ量	フタメッキ 剥離	膨れ量
はんだ耐熱性 (288°C/10sec/3cycles)	なし	0	なし	0	なし	<5μm
熱衝撃性(-65°C/30min⇔ 125°C/30min/1000cycles)	なし	<4μm	なし	<4μm	なし	0
PCT (121°C/2atm/100%RH/336h)	なし	0	なし	0	なし	0